

スルーホールリフロー実装に係る要求事項 標準化 P G

◆ 目的・スコープ

- スルーホールリフロー実装を行う上で必要となる用語、部品、材料、プリント配線板或はプロセス等についての要求事項の標準化を図る。
- 同上のJEITA規格化、IEC規格化を進める。

◆ 活動の概要

- 電気・電子機器の実装では、プリント配線板に表面実装部品を一括してはんだ付けするリフローソルダリングが主な工法となっている。その中で、例えばハイパワー部品等で表面実装部品化が困難な挿入部品は、手はんだ付け、レーザーはんだ付け或は部分はんだ付け等で対応されて来ている。しかし、工数が掛かる、設備が必要などの理由から挿入部品のリードを表面実装プロセスではんだ付けを行うスルーホールリフロー実装の採用が進んできている。
- しかしスルーホールリフロー実装を行う上では、挿入部品などについての種々の要求事項があり、その内容が各社バラバラで、部品・プリント配線板・プロセスを担当する会社には混乱が生じていて、要求事項の標準化が求められている。
- そこで、「スルーホールリフロー実装に係わる要求事項」の標準化に取り組むために、セットメーカ・部品メーカ・材料メーカ・装置メーカなど関係者からなるプロジェクトを2017年3月に発足させ、約一年の活動の結果ET-7505を纏め、JEITA規格として制定した。
- 更に、纏めたET-7505のIEC規格化を図るとし、IEC 61760-3の改定としてIECに提案し、現在審議中。

◆ 担当する規格

IEC国際規格	対応JIS	JEITA規格	名称
IEC 61760-3	無し	無し	Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering
IEC 61760-3 の改定を提案中	無し	ET-7505	スルーホールリフロー実装に係る要求事項